

# 鼎华DH-B1 服务好的BGA返修台三温区触摸屏拆焊台

产品名称	鼎华DH-B1 服务好的BGA返修台三温区触摸屏拆焊台
公司名称	深圳市鼎华科技发展有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井镇万丰村大洋田工业园46栋三楼
联系电话	18902852819 18902852819

## 产品详情

功能介绍：

序号	名称	用途	
1	限位杆	限制上部加热最低位置	旋转到合适位置
2	松紧调节旋钮	锁紧上部温区的前后下下位置	旋转旋钮
3	前后调节手柄	调节上部温区的前后位置	旋转手柄
4	七字手柄	锁紧上部温区转动角度	旋转手柄
5	照明灯	设备工作时照明	按下按钮
6	PCB板夹	移动合适位置，夹紧PCB板	

7	下部温区高度调节手柄	调节下部风嘴离PCB板的距离	旋转手柄
8	急停按钮	紧急停机	按下按钮
9	照明灯按钮	照明灯开关	按下按钮
10	上部加热温区	产生上部热风	
11	上下调节手柄	调节上部温区的上下位置	旋转手柄
12	上部加热风嘴	使热风更集中均匀	使出风口距BC
13	下部支撑架	防止PCB板往下塌陷	移动合适位置
14	下部加热风嘴	使热风更集中均匀	使出风口距BC
15	横流风扇	PCB焊接后对PCB板冷却	
16	红外发热区	拆焊BGA时预热用	
17	测温接口	连接外部电偶，测量实际温度	直接连接测温
18	触控屏	操作平台储存系统资料	

主要参数：总功率 Total Power 4800W 上部加热功率 Top heater 800W 下部加热功率 Bottom heater 800W 第二温区1200W，第三温区2700W（加大型发热面积以适应各类P板）电源 power AC220V ± 10% 50/60Hz 外形尺寸 Dimensions L800 × W900 × H750 mm 定位方式 Positioning V字型卡槽,PCB支架可X方向调整并外配万能夹具 温度控制方式 Temperature control K型热电偶（K Sensor）闭环控制（Closed loop）温度控制精度 Temp accuracy ± 2度 PCB尺寸 PCB size Max 500 × 400 mm Min 22 × 22 mm 适用芯片 BGA chip 2X2-80X80mm 适用最小芯片间距 Minimum chip spacing 0.15mm 外置测温端口 External Temperature Sensor 1个，可扩展（optional）机器重量 Net weight 45kg

描述：1.

嵌入式工控电脑，高清触摸屏人机界面，PLC控制,并具有瞬间曲线分析功能.

实时显示设定和实测温度曲线，并可对曲线进行分析纠正。

高精度K型热电偶闭环控制和温度自动补偿系统，并结合PLC和温度模块实现对温度的精准控制，2.

保持温度偏差在 ± 2度.同时外置测温接口实现对温度的精密检测，并实现对实测温度曲线的精确分析和校对.3.

PCB板定位采用V字型槽，定位快捷、方便、准确，满足不同PCB板排版方式及不同大小PCB板的定位.

4. 灵活方便的可移动式万能夹具对PCB板起到保护作用，防止PCB边缘器件损伤及PCB变形，并能适应各种BGA封装尺寸的返修.5.

配备多种规格合金风嘴，该风嘴可360度任意旋转定位，易于安装和更换；6. 上下共三个温区\*\*\*\*加热，三个温区可同时进行多组多段温度控制，保证不同温区同步达到最佳焊接效果。加热温度、时间、斜率、冷却、真空均可在人机界面上完成设置。7. 上下温区均可设置6段温度

控制，可以扩展成8段，可海量存储温度曲线，随时可根据不同BGA进行调用,在触摸屏上也可进行曲线分析、设定和修正；三个加热区采用\*\*\*\*的PID算法控制加热过程，8.

升温更均匀，温度更准确；9. 采用大功率横流风机迅速对PCB板进行冷却，以防PCB板的

变形；同时内置真空泵，外置真空吸笔，以方便快捷取拿BGA芯片；10. 配置声控“提前报警”功能.在拆卸、焊接完成前5-10秒以声控方式警示作业人员作相关准备。上下热风停止加热后，冷却系统启动，待温度降至常温后自动停止冷却。保证机器不会在热升温后老化！11.

经过CE认证，设有急停开关和突发事件自动断电保护装置。